关于征集2017（第十届）中博会科技项目

融资需求的通知

各挂牌企业:

2017年5月第十届中博会(徽商大会)在合肥召开，届时合肥市将召开资本+创新对接峰会，有150家金融机构、股权投资机构参加。为了帮助有项目融资需求的科技企业和团队与金融机构对接，中心现面向挂牌企业征集科技项目融资需求，统一报送给合肥市科技局。届时，合肥市科技局将会编印成册分发给参会投资机构，并选出部分项目单位参加资本对接活动，开展布展和路演。此外，此次征集的企业项目将向合肥市科技金融合作的银行、投资公司等金融机构推荐。请有意愿的挂牌企业于4月10日前将科技项目融资需求表、企业及产品宣传照片、项目成果照片（电子版）报送至中心机构服务部。

附件：科技项目融资需求表

联系人：陈云

联系电话： 0551-65871955

电子邮箱：jgfwqy@ahsgq.com

安徽省股权托管交易中心有限责任公司

2017年3月30日

科技项目融资需求表

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 公司名称 |  | 成立时间 |  |
| 注册地址 |  | 法定代表人（团队负责人） |  |
| 注册资本 |  | 实收资本 |  |
| 办公地址 |  | 所属行业 |  |
| 联系人 |  | 职务 |  |
| 手机 |  | 邮箱 |  |
| 公司（团队）、主要产品简介  (500字左右) |  | | |
| 融资项目简介  （创新点、所属领域等，500字左右） |  | | |
| 需融资金额 |  | | |
| 融资方式 | □股权 □债权 | | |

另单独附企业宣传图片2-3张，产品图片3-5张。